

3 证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 电话会议 ☐ 其他（ ）
参与单位名称	<u>2025 年 8 月 22 日</u> APC International、IGWT Investment、博道基金、工银瑞信、国泰基金、泓德基金、华夏基金、嘉实基金、民生加银基金、银华基金等 <u>2025 年 8 月 24 日</u> 财通资管、东吴基金、汇丰晋信、交银施罗德、平安基金、新华基金、兴业基金、易方达、招商基金等 <u>2025 年 8 月 25 日</u> 公开业绩说明会 <u>2025 年 8 月 25 日</u> 博时基金、淡水泉投资、汇添富、泾溪投资、国泰基金、富国基金、诺安基金、盘京投资、沅杨资产等
时间	2025 年 8 月 22 日、2025 年 8 月 24 日、2025 年 8 月 25 日
调研方式	线上及线下会议

公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。 公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。 基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。 为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。 基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。 芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有

	14nm/10nm/7nm/6nm/5nmFinFET 和 28nm/22nmFD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2025 年的统计，从半导体 IP 销售收入角度，芯原是 2024 年中国大陆排名第一、全球排名第八的半导体 IP 授权服务提供商；2024 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的报告和企业公开数据，在全球排名前十的 IP 企业中，芯原的 IP 种类排名前二。随着后续客户产品的逐步量产，公司将进一步提升特许权使用费收入，公司 IP 授权业务的规模效应将进一步扩大。 2025 年第二季度，公司实现营业收入 5.84 亿元，环比增长 49.90%，主要由知识产权授权使用费收入及量产业务收入增长所带动。公司潜心投入关键应用领域技术研发，如五年前开始布局 Chiplet 技术及其在生成式人工智能和智慧驾驶上的应用，并持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户。公司在手订单已连续七个季度保持高位，再创公司历史新高，截至 2025 年第二季度末，公司在手订单金额为 30.25 亿元，较 2025 年第一季度末增长 5.69 亿元，环比增长 23.17%。公司技术能力业界领先，并持续获得全球优质客户的认可，2025 年第二季度，公司新签订单 11.82 亿元，单季度环比提升近 150%，支撑未来公司收入增长。
交流问答	问题：请问公司在人工智能领域有哪些布局，业务合作情况如何？ 回复：基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。 我们积极布局智慧汽车、AR/VR 等增量市场，已经为多家国际行业巨头客户提供了技术和服务。目前，集成了芯原 NPU IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货近 2 亿颗，主要应用于物联网、可穿戴设备、

	智慧电视、智慧家居、安防监控、服务器、汽车电子、智能手机、平板电脑、智慧医疗等 10 个市场领域，在嵌入式 AI/NPU 领域全球领先，芯原的 NPU IP 已被 91 家客户用于上述市场领域的 140 余款 AI 芯片中；在 AI/AR/VR 眼镜领域，公司已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务，此外还有数家全球领先的 AI/AR/VR 客户正在与芯原进行合作。 问题：请问公司现在研发团队规模如何，未来在人才储备上有什么计划？ 回复：公司高度重视人才培养，坚持引进和培养优秀人才是公司生存和发展的关键，也是公司持续提高核心竞争力的基础，截至 2025 年 6 月末，公司研发人员合计 1,805 人，研发人员的占比为 89.31%，研发人员中硕士及以上学历人员占比达 88.76%。公司中国大陆地区具有十年以上工龄的员工占比为 26%，员工平均年龄为 32 岁。基于上述行业及公司特征，公司的研发能力一直保持在较高水平，建立了理论知识扎实、研发实力强、经验丰富的研发团队，保持了业务的竞争优势，从而打造了高竞争壁垒。 经过 20 多年的持续高研发投入，公司已经拥有丰富且优质的人才和技术储备，并在别的公司不招人、少招人的情况下，芯原仍然逆向思维招收优秀应届毕业生。在 2024 届校招中，近 1 万人参加了全球统一在线笔试，约 1,800 人进入面试环节，公司最终录取了 200 多名应届毕业生，其中，硕士 985、211 院校的占比为 97%，本硕都是 985、211 院校的占比 85%。在 2025 届校招中，公司录取了 100 多名应届毕业生，其中硕士 985、211 院校的占比继续保持在 97%，本硕都是 985、211 院校的占比提升至 89%，超过去年。截至今年二季度末，近三年入职的应届生累计已申请 71 个专利。
--	---

问题：公司量产业务毛利率较低，预计什么时候可以实现毛利率的大幅提升？

回复：行业内芯片设计公司主要以设计并销售自有品牌芯片产品而开展业务运营，芯原的商业模式是给客户提供服务，而不是销售自有产品。在公司一站式芯片定制服务业务模式下，公司面对市场风险和库存风险压力较小，只需要以相对稳定的量产业务团队管理日益增长的量产业务，具有可规模化优势，因此量产业务产生的毛利可大部分贡献于净利润。随着公司一站式芯片定制能力提升，为客户带来更高价值，公司参与度及附加值更高客户项目收入占比增加，带动公司量产服务议价能力等核心竞争力的提升，将有利于量产业务毛利率的提升。

问题：在今年第二季度，公司一站式芯片定制业务订单环比大幅增长，反映了市场的那些需求？公司的技术竞争力体现在哪里？

回复：近期主要受到 AI 云侧、端侧需求带动，公司订单增长明显。从新签订单整体情况看，在今年第二季度，ASIC 业务中设计收入新签订单超过 7 亿元，环比增长超 700%，同比增长超 350%；量产业务新签订单近 4 亿元。随着这些订单逐步转化为收入，ASIC 业务将持续推动业绩增长，为公司未来营业收入的提升提供坚实支撑。

针对 AI 类市场需求，就芯原 ASIC 定制技术而言，公司已拥有包括 FinFET 和 FD-SOI 先进工艺节点在内的芯片成功流片经验，目前已实现 5nm FinFET 系统级芯片一次流片成功，多个 5nm/4nm 一站式服务项目正在执行。公司针对 AI 端侧、云侧均拥有丰富的半导体 IP 和相关技术平台积累。例如，在 AI 端侧应用上，芯原已经深耕多年。芯原全球领先的 NPU IP，已经在 91 家客户的 140 多款芯片中获得采用，覆盖了服务器、汽车、智能手机、可穿戴设备等 10 多个市场领域，相关芯片出货已经近 2 亿颗。目前，芯原的 NPU 可以为移动端大语言模型推理提供超过 40 TOPS 算力，并且已经在知名企业的手机和平板电脑中量产出货。此外，

	在上半年，芯原的 AI-ISP 芯片定制方案也已经在知名厂商的智能手机中量产。在云侧，比如数据中心和服务器领域，芯原的 VPU、NPU 和 GPGPU IP 都获得了广泛应用。今年上半年，我们面向汽车和边缘 AI 服务器推出了可扩展的高性能 GPGPU-AI 计算 IP，并且正在与多家领先的 AI 计算客户深度合作。 同时，公司还提供芯片设计相关的全套软件解决方案。芯原一站式芯片定制服务的整体市场认可度不断提高，已占据有利地位，经营成果不断优化，特别是当英特尔、博世、恩智浦、亚马逊、谷歌、微软等众多在其各自领域具有较强的代表性和先进性的国内外知名企业成为芯原客户并且形成具有较强示范效应的服务成果后，公司在品牌方面的竞争能力进一步增强。 问题：公司作为平台公司，预计多大的业务规模可以实现盈利？公司第二季度订单增长趋势持续性如何？ 回复：公司在手订单已连续七个季度保持高位，再创公司历史新高，截至 2025 年第二季度末，公司在手订单金额为 30.25 亿元，较 2025 年第一季度末增长 5.69 亿元，环比增长 23.17%。2025 年第二季度末在手订单中，一站式芯片定制业务在手订单占比近 90%。2025 年第二季度末在手订单中预计一年内转化的比例约为 81%，为公司未来营业收入增长提供了有力的保障。 坚持引进和培养优秀人才是公司生存和发展的关键，也是公司持续提高核心竞争力的基础。公司拥有丰富且优质的人才和技术储备，并在别的公司不招人、少招人的情况下，芯原仍然逆向思维招收优秀应届毕业生。在 2025 届校招中，公司录取了 100 多名应届毕业生，其中硕士 985、211 院校的占比继续保持在 97%，本硕都是 985、211 院校的占比提升至 89%，超过去年。截至今年二季度末，近三年入职的应届生累计已申请 71 个专利。得益于公司优异的招聘质量和高效的培训机制，近年招聘的应届毕业生已完成内部培训并对今年已经展开和正要承接的多个芯片大项目
--	--

	提供了必要的人力资源。未来随着行业逐步复苏，公司项目数量增加，这批研发人员将在各自岗位上发挥关键作用。 问题：请问公司在智慧驾驶 Chiplet 领域的进展有哪些？ 回复：芯原在为客户定制 ADAS/自动驾驶芯片的过程中发现，设计周期长、单芯片（大芯片）良率较低、生产受限以及算力扩展困难是客户面临的主要挑战。Chiplet 技术能够有效解决单颗芯片无法满足的算力需求问题，并有效提升高端芯片的良率、降低整体成本；此外，Chiplet 技术可以将不同工艺节点、材质、功能和供应商的特定功能裸片集中封装，从而灵活地为高性能芯片扩展算力，快速升级迭代，并降低设计和供应的风险。 为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。目前，公司已经积累了为汽车厂商设计高性能车规 ADAS 芯片的相关经验，例如为某知名新能源汽车厂商提供基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，并拥有基于 Chiplet 架构的高性能计算芯片、CoWoS 封装、UCIe/BoW 兼容的物理层接口等成功设计案例和经验，正在积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发。
--	---